



ASEAN・インドの半導体産業の現在地

(2026年6月19日、国立研究開発法人 科学技術振興機構
アジア・太平洋総合研究センター 第55回アジア・太平洋研究会)

(株)日本総合研究所 調査部
熊谷 章太郎

本資料は、情報提供を目的に作成されたものであり、何らかの取引を誘引することを目的としたものではありません。本資料は、作成日時点で弊社が一般に信頼出来ると思われる資料に基づいて作成されたものですが、情報の正確性・完全性を保証するものではありません。また、情報の内容は、経済情勢等の変化により変更されることがあります。本資料の情報に基づき起因してご閲覧者様及び第三者に損害が発生したとしても執筆者、執筆にあたっての取材先及び弊社は一切責任を負わないものとします。

本日はお話しすること

1. 世界の半導体産業の潮流
2. ASEAN諸国とインドの半導体産業を取り巻くビジネス環境
3. ASEAN諸国とインドの半導体産業の発展に向けた取り組み
4. ASEAN諸国とインドの半導体産業の競合・補完関係

本日の報告の視点と狙い

- 「ミクロ」から「マクロ」の視点へ
 - 個別企業の動向に終始せず、各国産業を取り巻くビジネス環境・制度等の全体像を体系的に理解する
- 「点」から「面」の視点へ
 - 特定国の動向の個別分析にとどまらず、各国間の共通点・相違点や、競合・補完関係を多角的に捉える

世界の半導体産業の潮流

アジアの半導体・エレクトロニクス産業発展の歴史

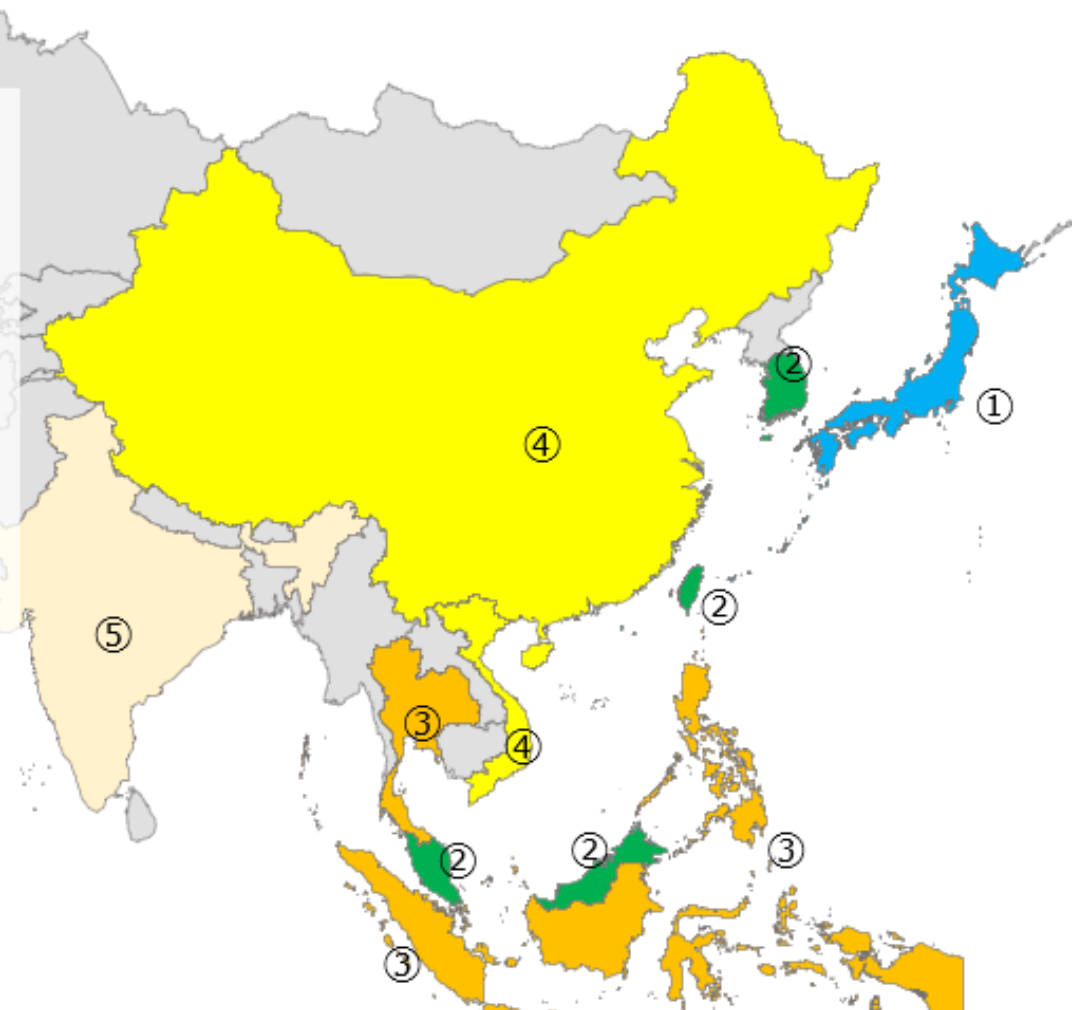
①1950年代～:日本で発展

②1970年代～:韓国、台湾、シンガポール、マレーシアで発展開始

③1990年代～:タイ、インドネシア、フィリピンで発展開始

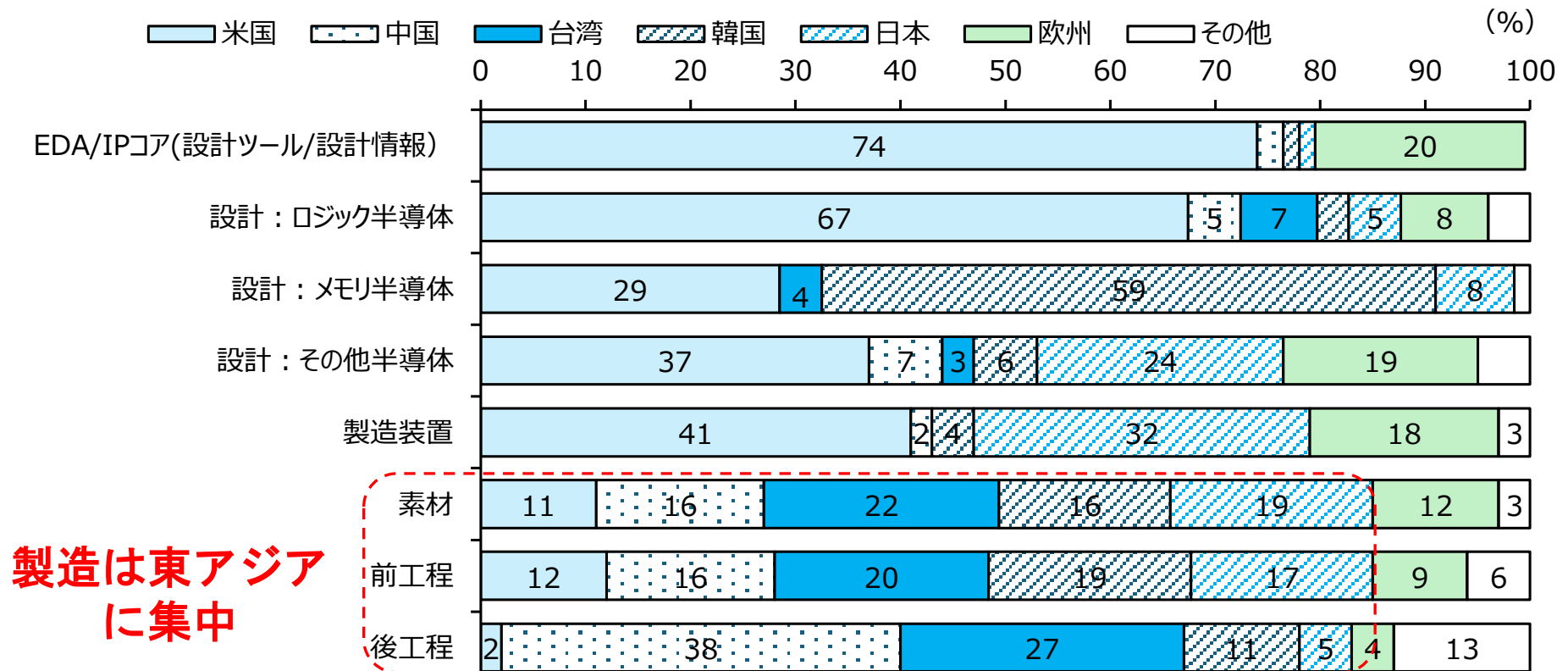
④2000年代～:中国とベトナムで発展開始（中国に集約化する動きも）

⑤2010年代後半～:インドで発展開始



設計は米国が、製造は中国と台湾が高いプレゼンス

世界の半導体の市場セグメント別の付加価値に占める 各国・地域の割合（2019年）

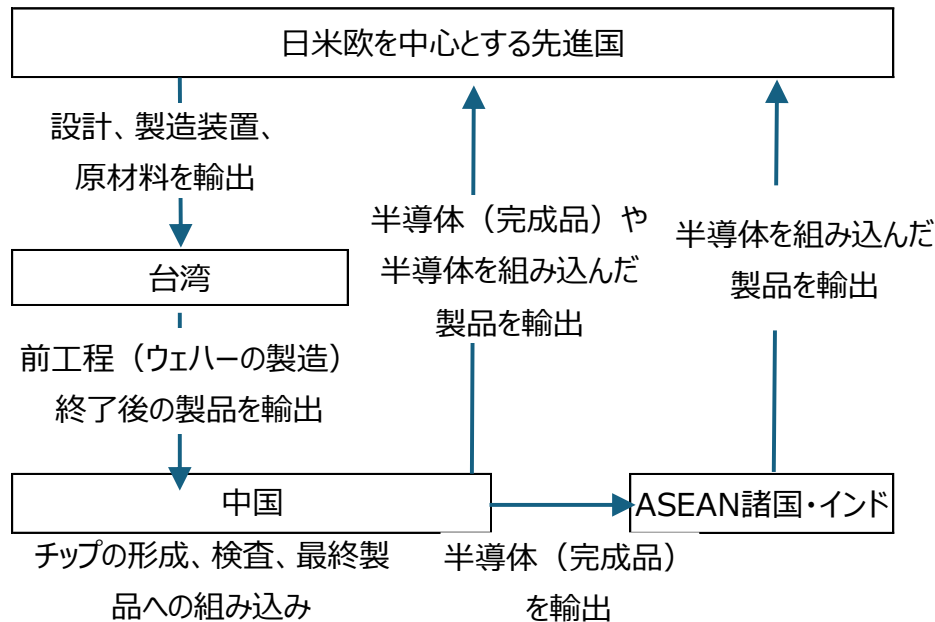


(資料) SIA "State of The U.S Semiconductor Industry "を基に日本総合研究所作成

米国の半導体サプライチェーン再編の方向性①

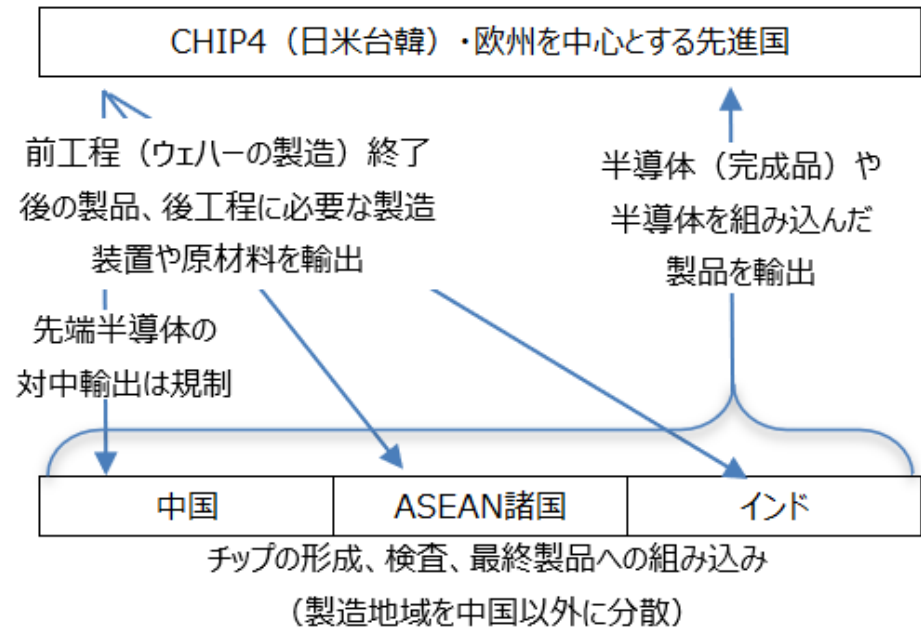
バイデン政権は、前工程の台湾依存度と後工程の中国依存度の引き下げに向けたサプライチェーン再編を推進

＜従来のサプライチェーン＞



＜バイデン政権が目指した新たなサプライチェーン＞

米国と価値観を共有する国・地域と連携して設計や前工程など付加価値の高い工程を実施



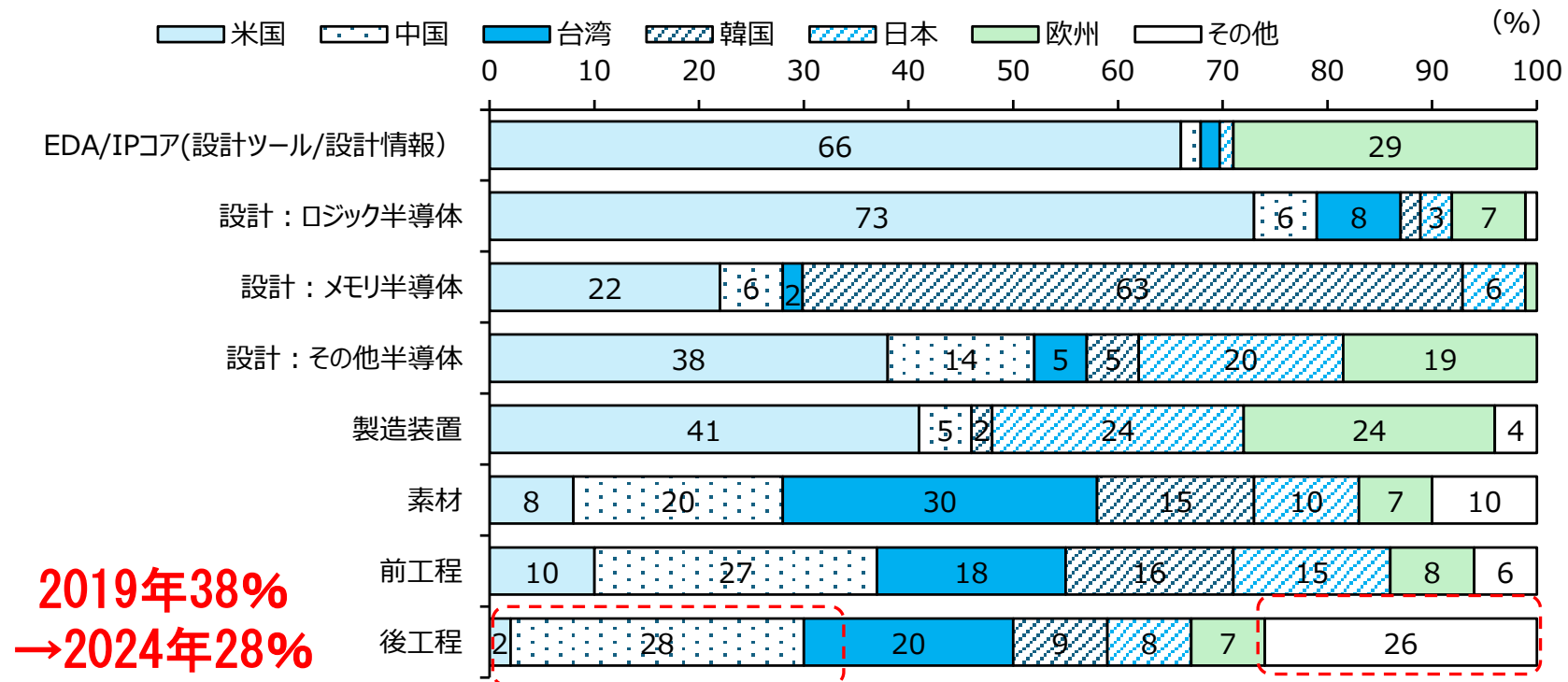
（資料）日本総合研究所作成

（注）世界の半導体の大まかなサプライチェーンをイメージ化したものであり、企業・製品によって流れは異なる。

半導体のサプライチェーン再編は道半ば

バイデン政権の4年間で間、後工程「その他」の割合が若干上昇したものの、東アジアに依存する構図は大きく変わらず

世界の半導体の市場セグメント別の付加価値に占める各国・地域の割合（2024年）



(資料) SIA "State of The U.S Semiconductor Industry "を基に日本総合研究所作成

次世代の国づくり

2019年13% → 2024年26%

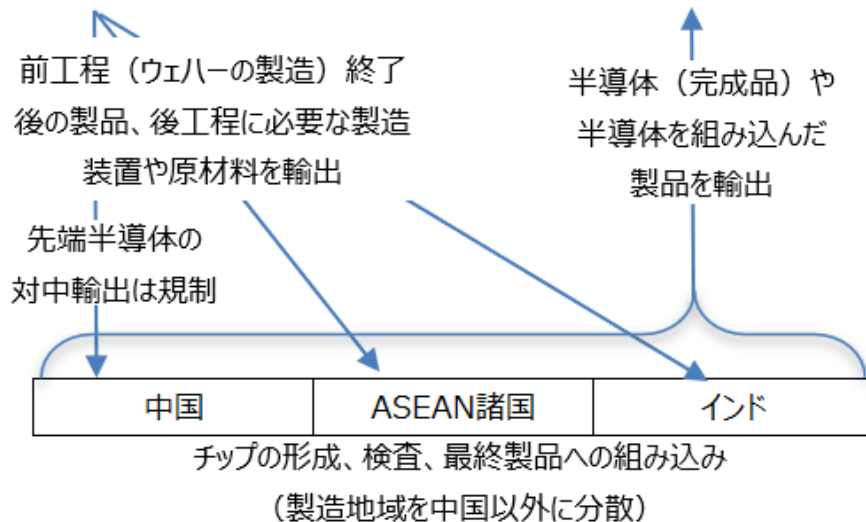
米国の半導体サプライチェーン再編の方向性②

トランプ政権はサプライチェーンの分散よりも米国への生産移転を最優先

<バイデン政権が目指した新たなサプライチェーン>

米国と価値観を共有する国・地域と連携して
設計や前工程など付加価値の高い工程を実施

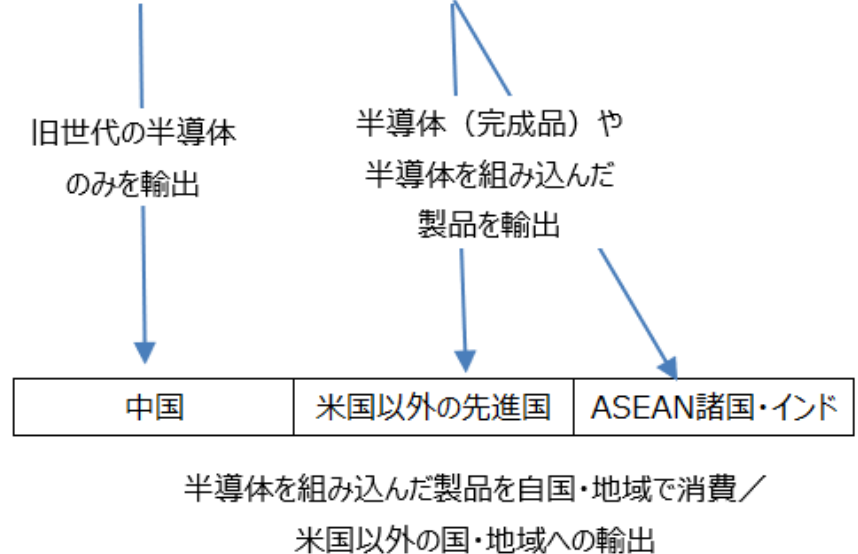
CHIP4（日米台韓）・欧州を中心とする先進国



<トランプ政権が目指すサプライチェーン（長期）>

設計、製造、製造装置、原材料などの米国への移転を促進し
輸入減少と輸出拡大を図る

米国



米国が東アジアの半導体生産機能を代替できない3つの理由

関税政策で輸入
コストは一段と増加

移民規制厳格化で
人手不足は深刻化

トランプ政権の朝令暮
改、次期政権の政策

**高コスト
体質**

**半導体
人材不足**

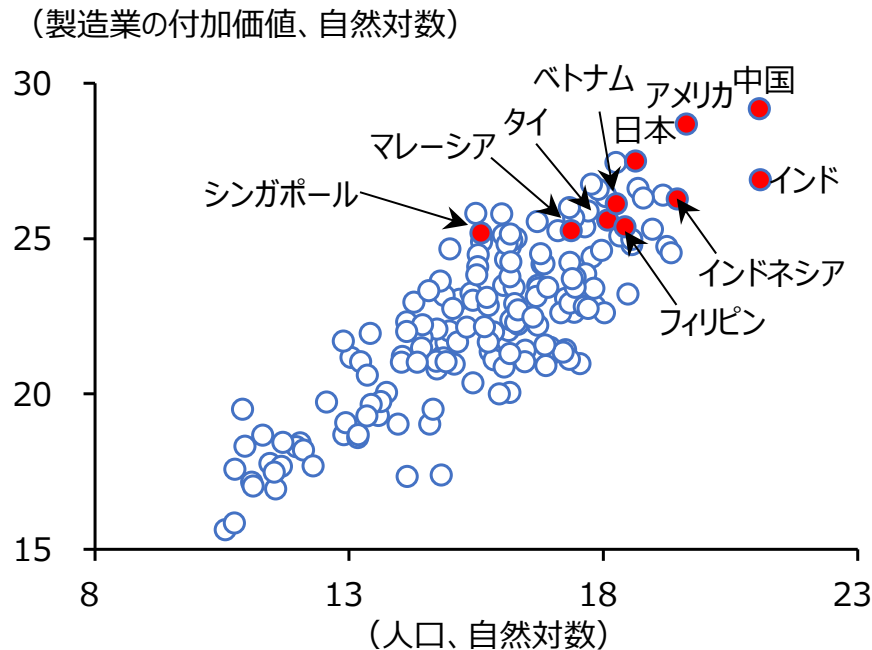
**通商政策
を巡る不
透明感**

東アジアの地政学リスクに対応するために、
ASEANやインドに生産拠点を分散する動きは継続

ASEAN諸国とインドの 半導体産業を取り巻くビジネス環境

人口／販売市場の大きさ≠半導体産業のポテンシャル

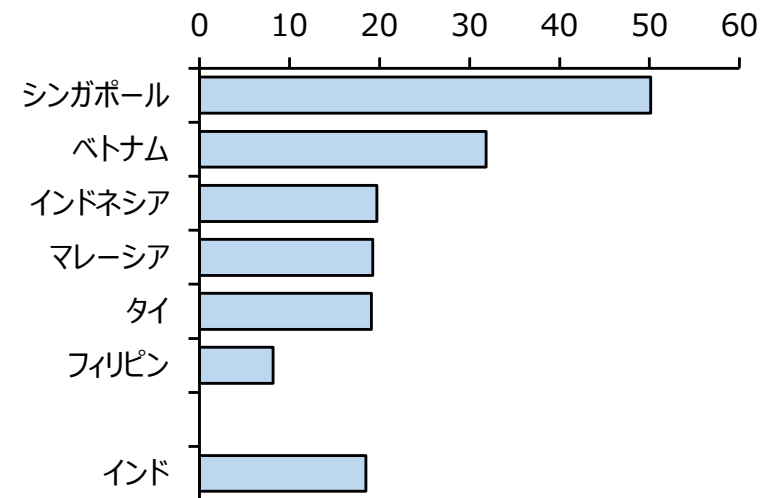
各国・地域の人口と製造業の付加価値（2023年）



（資料）World Bankを基に日本総合研究所作成

ASEAN諸国とインドの エレクトロニクス産業の付加価値 （2022年）

（10億ドル）

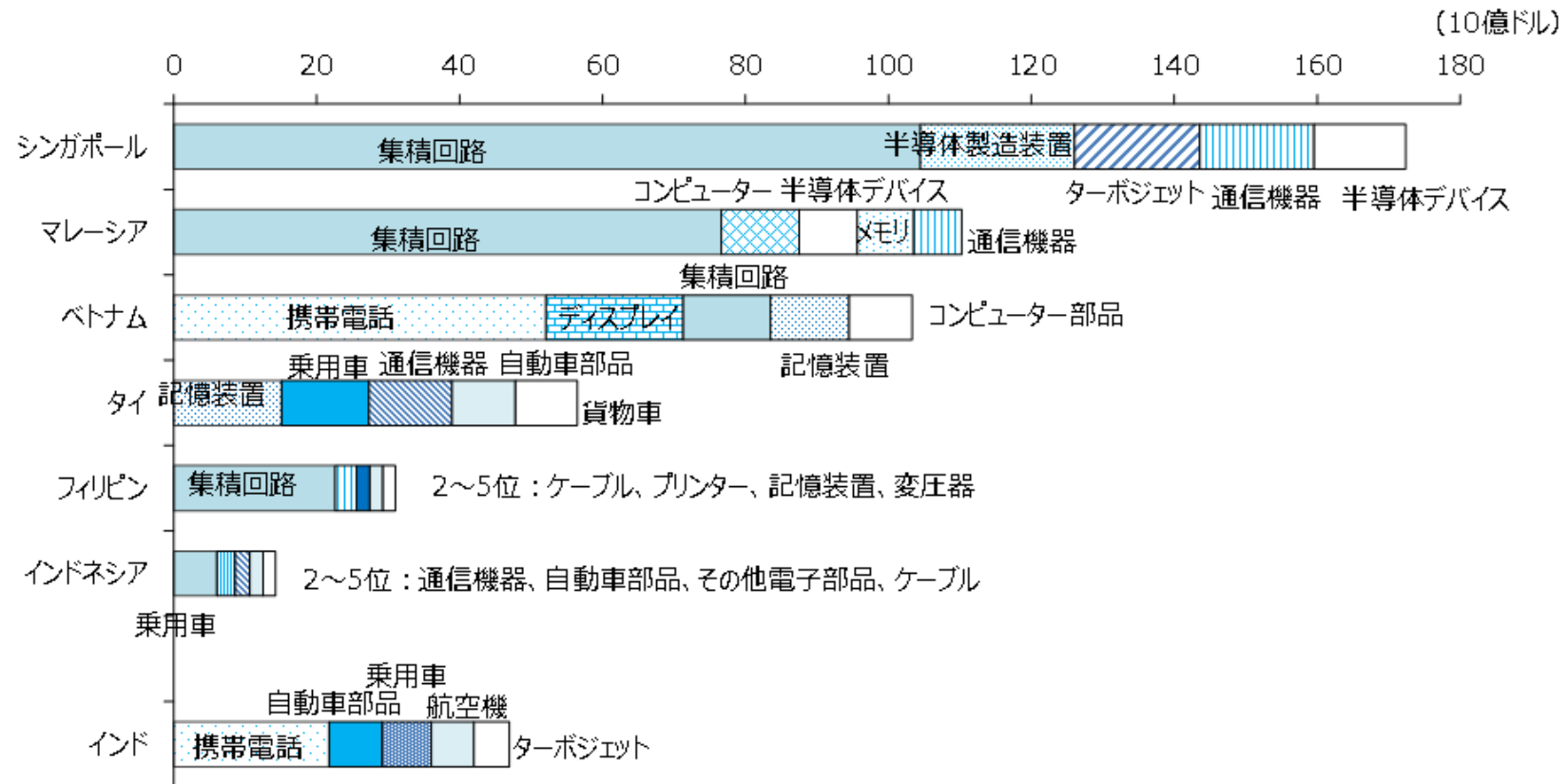


（資料）UNIDO を基に日本総合研究所作成

（注）エレクトロニクス産業は、UNIDOの2桁産業分類の、「30 (Office, accounting and computing machinery)」、「31 (Electrical machinery and apparatus)」、「32 (Radio, television and communication equipment)」、「33 (Medical, precision and optical instruments)」の合計。

シンガポールとマレーシアが半導体産業では先行

ASEAN諸国とインドの機械産業の主要輸出品（2023～2024年）



(資料) United Nationsを基に日本総合研究所作成

(注) 各国の機械類 (HS85～91類) の輸出トップ5品目を4桁分類で抽出。インドネシア、シンガポール、ベトナムは2023年値、インド、フィリピン、タイは2024年値。

なぜ、シンガポールとマレーシアが先行しているか？

半導体産業の発展にとって特に重要なのは、物流・エネルギー
インフラや政治的安定性

質の高い
電力

安定的な
水供給

高度人材の
雇用環境

物流
インフラ

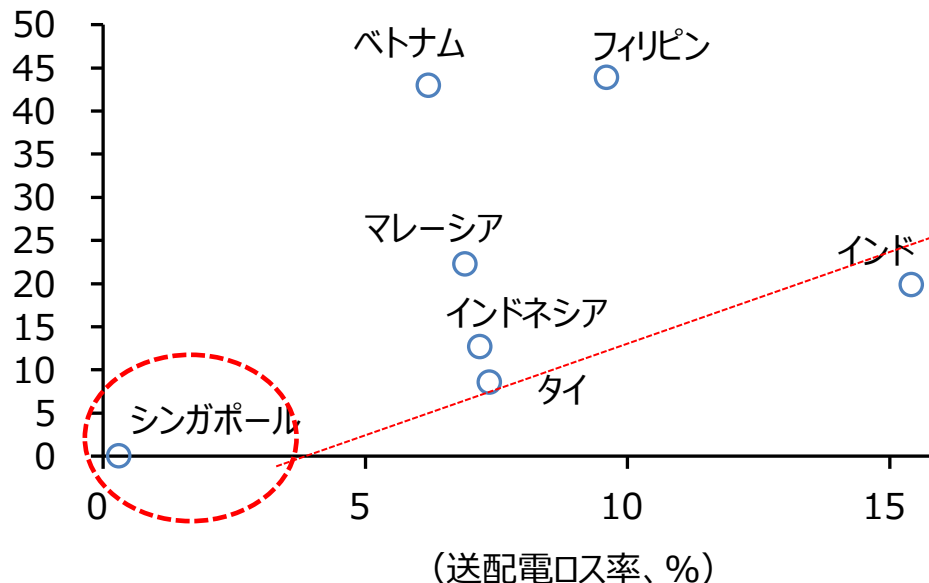
政治的
安定性

税制優遇措置・
産業補助金

ASEAN・インドのビジネス環境の比較①

ASEAN諸国とインドの送配電ロス率 (2022年) と過去1年間で停電を経験し た企業の割合 (2016~2024年の直近値)

(過去1年間で停電を経験した企業の割合、%)



シンガポール以外の
ASEAN諸国とインドは
「質の高い電力」の供
給に課題

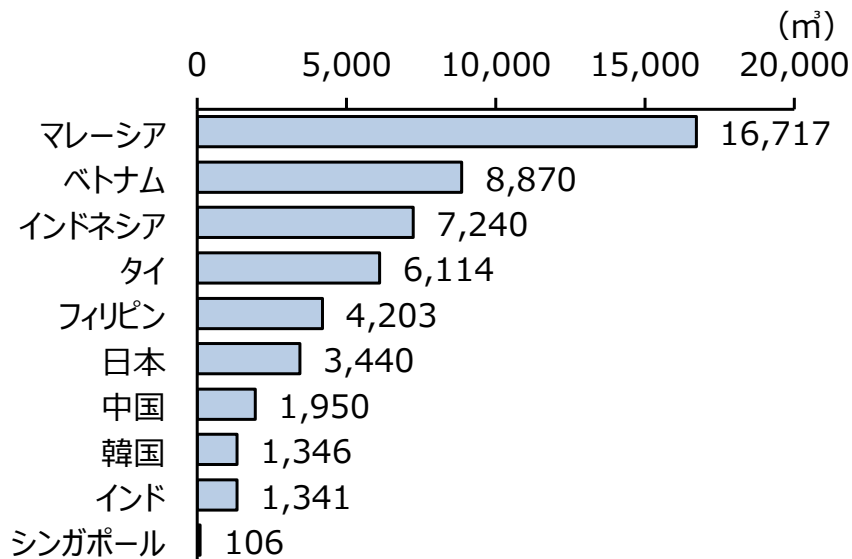
(資料) World Bank "World Development

Indicators"、"Enterprise Survey"を基に日本総合研究所作成

ASEAN・インドのビジネス環境の比較②

シンガポールは水資源は乏しいものの、水供給は他国よりも安定

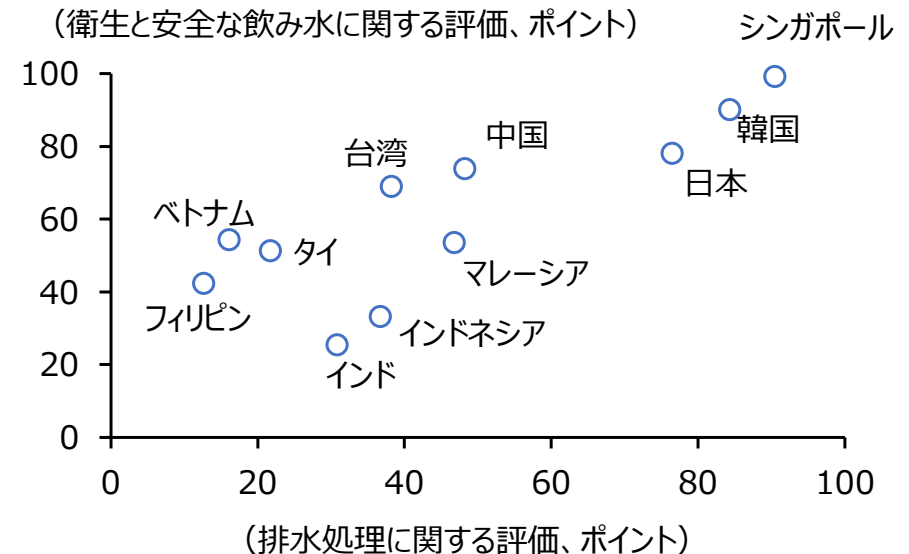
一人当たり年間水資源賦存量 (2022年)



(資料) Food and Agriculture Organization

"AQUASTAT"を基に日本総合研究所作成

アジア各国・地域の 環境パフォーマンス指数に おける水関連の評価



(資料) Yale University "Environmental Performance Index 2024" を基に日本総合研究所作成

ASEAN・インドのビジネス環境の比較③

給与水準の高いシンガポールは海外からの高度人材の呼び込みが容易

アジア各国・地域の 半導体産業の就業者数

	万人	参照年	参照資料
中国	54.1	2020 ～2021年	三浦[2023](元データは中国電子情報産業発展研究院)
台湾	31.7	2023年	アジア・太平洋総合研究センター[2025](元データは国家発展委員会)
日本	19.4	2023年	経済産業省「経済構造実態調査」
韓国	14.7	2022年	アジア・太平洋総合研究センター[2025](元データは韓国雇用情報院)
シンガポール	3.5	2024年	EDB(シンガポール経済開発庁)ホームページ

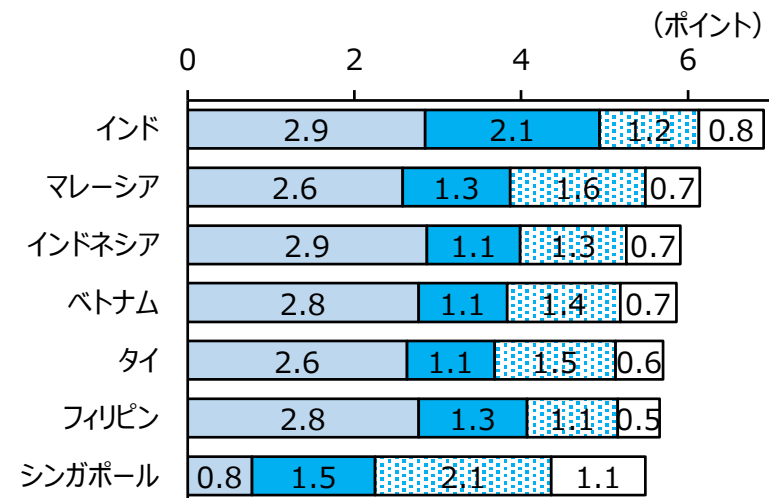
(資料) 日本総合研究所作成

(注) 半導体産業の範囲は国・地域毎に一部異なるため、国際比較の際には幅を持ってみる必要がある。

次世代の国づくり

グローバル・サービス・ ロケーション指数 (2023年)

- Financial attractiveness (コスト面の競争力)
- People skills and availability (スキル・人材の豊富さ)
- Business environment (ビジネス環境)
- Digital resonance (デジタル関連のビジネス環境)

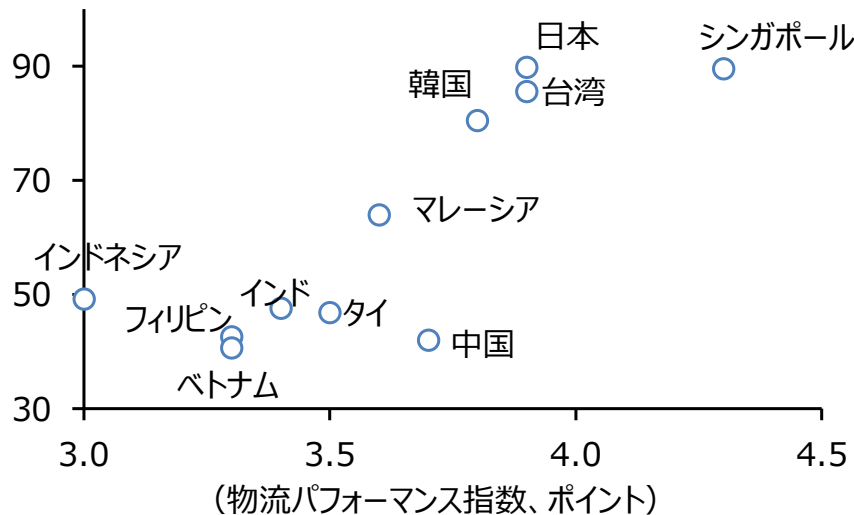


(資料) Kearney "2023 Global Services Location Index" を基に日本総合研究所作成

ASEAN・インドのビジネス環境の比較④

物流パフォーマンス指数と 世界ガバナンス指標（2023年）

（世界ガバナンス指標、パーセンタイルランク）



（資料）World Bankを基に日本総合研究所作成

（注）物流パフォーマンス指数は、物流インフラの質、通関手続き、物流サービスの品質などを0～5点の間で評価した指数。世界ガバナンス指標は、政府の説明責任、政治的安定性、汚職などの状況を百分率順位で評価したもの（全評価項目の平均値をプロット）。

＜一連の指標が示唆すること＞

今後、インドネシア、タイ、フィリピン、ベトナム、インドが半導体産業の発展を目指す上ではビジネス環境の改善が最重要課題

ASEAN諸国とインドの 半導体産業の発展に向けた取り組み

ASEAN諸国とインドの半導体産業の発展に向けた取り組み

ビジネス環境や製造業の発展段階の違いに応じた取り組みを展開

	シンガポール	マレーシア	ベトナム	タイ	フィリピン	インドネシア	インド
長期の開発目標	経済戦略 2030	Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 (繁栄共有ビジョン)	社会経済発展戦略	タイランド 4.0	Ambisyon Natin 2040 (我々の野心2040)	黄金のインドネシア 2045	Viksit Bharat 2047 (発展したインド)
半導体産業に特化した戦略・政策など	なし	国家半導体戦略	2030年までのベトナムの半導体産業の発展戦略と2050年までのビジョン	国家半導体戦略	半導体・エレクトロニクス産業ロードマップ	半導体産業の発展ロードマップ	ISM (インド半導体ミッション)
注力／注目分野	先端半導体の製造、R&D	短期：後工程の発展	エレクトロニクス製品向け半導体の後工程、設計、R&D	レガシー半導体の後工程誘致 (車載向け半導体)	人材育成	半導体原材料の製造	設計
	先端技術を用いたレガシー半導体の製造	中長期：地場企業の育成 (製造・設計)			レガシー半導体の後工程誘致	レガシー半導体の後工程誘致	レガシー半導体の後工程誘致

各国の取り組み①高付加価値化を進めるシンガポール

注力／注目分野	左記に関連した具体的な動き
スマートフォンやAI向けサーバーなどで利用される先端半導体製造	マイクロンによるHBM（広域帯メモリ）の後工程工場建設（2025年着工）
次世代半導体に関する研究開発	窒化ガリウム半導体に特化した国立イノベーションセンターの開設（2025年開設）
比較的付加価値の高いレガシー半導体の製造拡大	TSMC傘下の世界先進積体回路とオランダの半導体大手NXPセミコンダクターズの合併による回路線幅40～130ナノメートル半導体製造工場建設計画（2024年6月発表）
先端技術を用いたレガシー半導体の製造効率化	グローバルファウンドリーズによる電力や水のエネルギーの利用効率の高いレガシー半導体工場の稼働（2023年稼働）

各国の取り組み②地場企業の育成を目指すマレーシア

注力／注目分野	左記に関連した具体的な動き
外資誘致を通じた産業集積 (後工程とともに前工程も意識)	テキサス・インスツルメンツ、マイクロン、 インフィニオンテクノロジーズ、ロームなどによる投資 インフィニオンテクノロジーズによるSiC（シリコンカーバイド）半導 体の前工程工場の稼働（2024年）
地場企業の育成 (後工程を担う年間売上高100億リング以上の 地場企業を10社以上育成するとともに、年間売 上高が10億リング以上の半導体 関連企業を100社以上育成することを目標)	半導体設計大手アームとの半導体設計人材の育成における連 携に関する覚書を踏まえた、地場の1万人に対するエンジニア育 成プログラムの提供
地場企業の国際競争力引き上げ (アップル、ファーウェイ、レノボといったグローバル 企業の先端的なスマートフォンやコンピューターで 用いられる半導体を設計・製造することを目標)	産官学の連携を通じた高度な知識を有する 6万人の技術者の育成計画 (250億リング（約8,300億円）を支出予定)

各国の取り組み③設計と後工程の発展を目指すベトナム

注力／注目分野	左記に関連した具体的な動き
後工程の誘致 (2030年までに後工程工場と前工程工場をそれぞれ10工場と1工場設立する目標)	地場の大手IT企業FPTや、複合企業のCTグループによる後工程工場の設立計画、通信大手ベトテルによる前工程の半導体工場を建設計画
研究開発 (レガシー半導体を特定用途向けにカスタマイズするための設計、設計した回路図とプログラムが仕様通りに動作するかの検証)	クアルコム、NVIDIA、サムスンなどによるイノベーションセンターの開設、半導体チップ試作支援国家センターの設立
ソフト・ハードインフラの整備 (2030年までに5万人の技術者育成)	エンジニアやエンジニアの育成に関わる専門家に対する税制優遇措置、主要大学における半導体に特化したプログラムの開講、ホアラック・ハイテクパーク（ハノイ）のインフラ整備

各国の取り組み④車載向け半導体産業の発展を重視するタイ

注力／注目分野	左記に関連した具体的な動き
アナログ半導体・パワー半導体の製造	ソニーによる車載用イメージセンサーの新工場の稼働、東芝によるパワー半導体の生産体制の増強計画、国営石油PTTとハナマイクロエレクトロニクスとの合併によるパワー半導体の前工程への参入
PCB（プリント基板）関連産業の誘致、家電・EV（電気自動車）産業の発展	PCB: ZDT（鵬鼎控股）や東山精密など台湾企業による事業拡大 家電：ハイアール（海爾）、ミデア（美的集団）、ハイセンス（海信集団）など中国企業によるタイ工場の立ち上げ EV: BYD、チェリー、MGモーターなどによる現地生産拡大
人材育成 （2030年までに8.5万人の専門人材・高度な技術者の育成を目標）	人材育成に関する米アリゾナ州立大学との戦略的提携、マイクロエレクトロニクス技術センター（TMEC）などの半導体研究センターの強化
インフラ整備	EEC（Eastern Economic Corridor、東部経済回廊）の開発（*） （*）ドムアン空港、スワンナプーム空港、ウタパオ空港を結ぶ高速鉄道網の整備、レムチャバン港やマプタプット港の開発、イノベーションセンターの整備

各国の取り組み④人材育成に注力するフィリピン

注力／注目分野	左記に関連した具体的な動き
後工程の誘致	テキサス・インスツルメンツによる工場拡張計画、経済産業省の「グローバルサウス未来志向型共創等事業」の補助金を活用したミネベアミツミによる後工程工場拡張計画
人材育成 (2028年までに半導体・エレクトロニクス産業産業に従事する熟練労働者を128,000人育成)	労働雇用省傘下のTESDA（技術教育技能開発庁）とエレクトロニクス産業の業界団体SEIPI（フィリピン半導体・電子部品産業連盟）の連携による「PSF（フィリピン資格フレームワーク）」の導入、技術系の職業訓練機関への「マイクロレデンシャル制度」の導入
インフラ整備	ルソン島における半導体およびAIサプライチェーンの強靱化に向けたLEC（Luzon Economic Corridor、ルソン経済回廊）の開発（*） （*）ルソン島中部の3大拠点（クラーク、マニラ、バタンガス）の高速物流網での連結、クラーク国際空港・バタンガス港の拡張など

各国の取り組み⑤素材分野に注力するインドネシア

注力／注目分野	左記に関連した具体的な動き
半導体向けの原材料産業の発展	シリカ・ダウンストリーミング・ロードマップ（2025～2045年）の策定、中国のガラス・太陽光パネル大手である信義ガラスによるシリカ砂の生産・加工工場の建設 ニッケル、コバルト、銅などの国内精錬事業の拡大に向けた輸出規制の厳格化
人材育成	インドネシアの主要大学、工業省、地場財閥ジャルムグループ傘下の大手家電メーカーポリトロンなどの連携により創設された非営利団体ICDECによる人材育成プログラムの提供（イギリスの半導体開発の学術団体であるSoC Labsや、ベルギーのナノエレクトロニクスの研究機関IMECと連携）
インフラ整備	バタム島・ガララン島の半導体エコシステムの開発に向けたコンソーシアムの形成
エレクトロニクス製品の製造拡大	台湾の大手EMSペガトロン（碩聯合科技）によるスマートフォンの製造工場の建設、ドイツのインフィニオン・テクノロジーズによる車載向け半導体の後工程工場の拡張、アップルの紛失防止タグ「Air Tag」の製造計画

各国の取り組み⑥手厚い補助金を軸に製造計画を推進するインド

注力／注目分野	左記に関連した具体的な動き
設計	DLI（Design Linked Incentive、デザイン連動型インセンティブ）の導入 NVIDIA、AMD、Qualcommなどによる インドの半導体設計・開発体制の強化
ISM（インド半導体ミッション）を通じた 半導体製造計画の推進	ISMの枠組みの中での12の投資案件の認可 （マイクロン、タタ・グループ、CGパワー、 HCL/フォックスコン、ケインズなど）
半導体産業向けの経済特区の開発	ドレラ特別投資地域（グジャラート州）の開発（＊） （＊）ドレラ国際空港、アーメダバードドレラ高速道路、 電力・水インフラの整備
エレクトロニクス産業の振興	ISM2.0を通じた半導体製造装置や原材料への補助金給付 PLIスキーム（生産連動型奨励策）やECMS（電子部品製造スキーム）を通じたエレクトロニクス産業の振興

2026年前半のトレンド

- 大きなトレンド（ASEAN・インドへの生産拠点の分散、インフラの制約を受けにくい後工程&設計を重視）は変わらず
- 2026年前半は高付加価値化を目指す動きが加速
 - 先端パッケージング（シンガポール、マレーシア）
 - 製造装置・原材料（インド）
 - 設計人材の育成（インドネシア）

2026年前半の各国の動向

国・地域	政策・制度面の動き	企業・実ビジネスの動き
シンガポール	2026年度予算における半導体産業の「国家最優先フラッグシッププログラム」への指定と8億シンガポールドルのR&D投資	NSTIC(国家半導体研究開発・イノベーションセンター)のパワー半導体部門の稼働
マレーシア	設計分野の強化方針を含む第13次マレーシア計画始動	SEMICON SEA 2026でMAPC(先端パッケージング連合)の発足
ベトナム	AIや半導体などに対する税制優遇措置を提供するデジタル技術産業法の成立	ベトテルによる前工程工場の着工(技術面のパートナー企業は不明)
タイ	国家半導体ロードマップの発表	インフィニオンテクノロジーズ(既存のレガシー半導体工場のマレーシアMPIへ売却+サムットプラカーンに次世代の車載パワー半導体後工程工場の建設投資を加速)
フィリピン	PSEI(半導体・エレクトロニクス産業ロードマップ)承認 米比共同「AIネイティブ産業サブ」	米Onsemiのパワー半導体の拡張計画
インドネシア	国家半導体ロードマップの正式公表	チップ設計エンジニア育成に向けた英Armとの包括契約 バタム島・ガララン島の半導体エコシステムの開発に向けたコンソーシアムの形成
インド	ISM(インド半導体ミッション)2.0の公表 ECM(電子部品製造スキーム)の予算増額	マイクロンの工場稼働 ISMで追加2件承認 ASMLとタタエレクトロニクスの技術協力提携

ASEAN諸国・インドが直面する課題・リスク

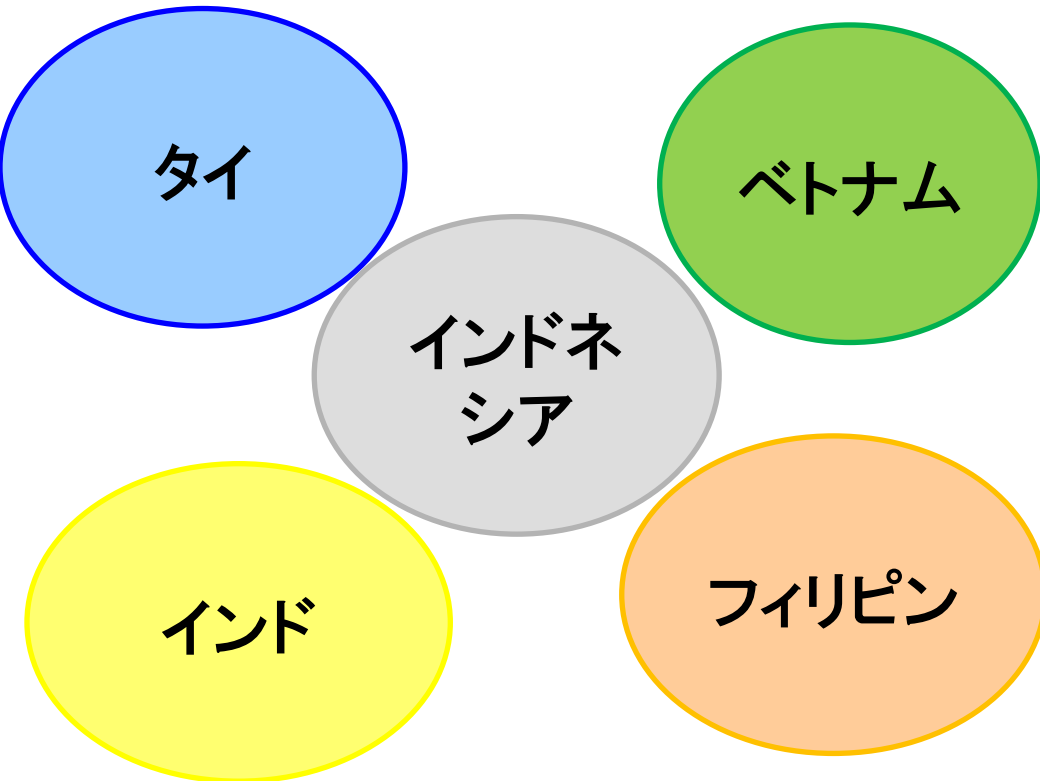
課題・リスク	左記が該当する国
国土の狭さに起因する 用地確保の遅れ・コストの高さ	シンガポール
政情不安を受けた 政策実行ペースの鈍化	インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ
財政悪化を受けた 税制優遇措置や 産業補助金制度の見直し	インドネシア、マレーシア、 フィリピン、タイ、インド
対米関係の悪化に伴う 投資マインドの悪化	インド

ASEAN諸国とインドの半導体産業の 競合・補完関係

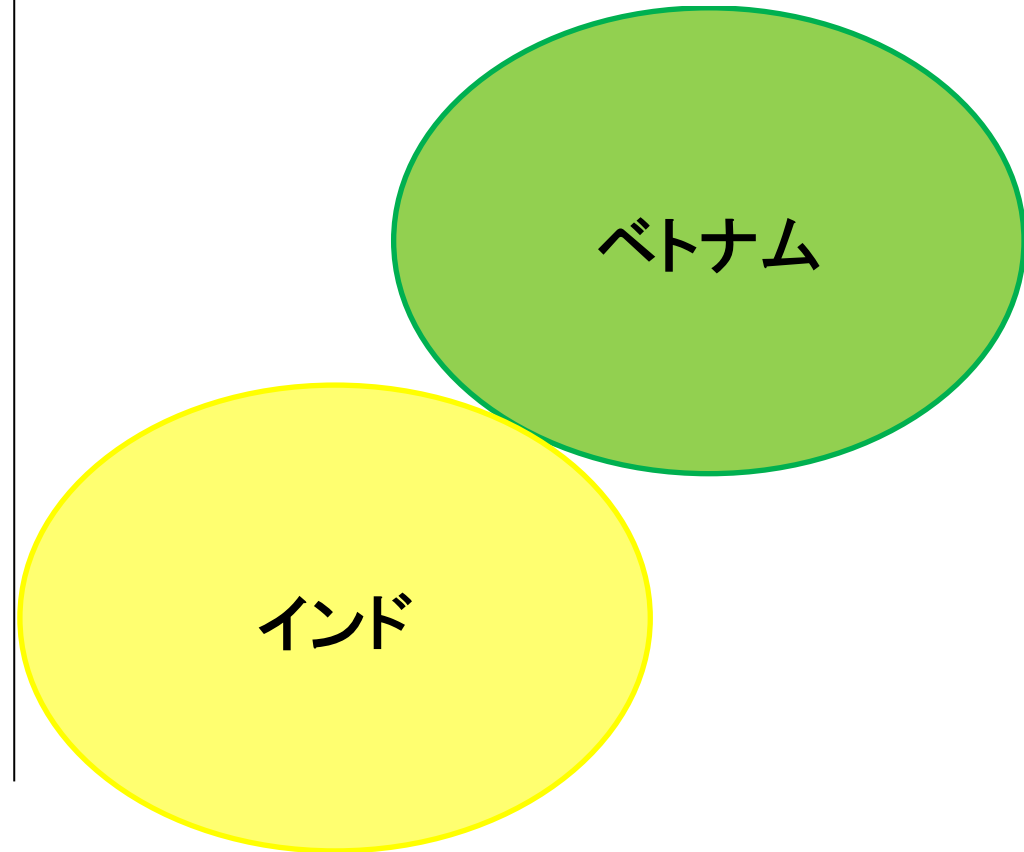
半導体産業は規模の経済が働きやすい産業

特定の国への生産集中が他国の発展を制約する可能性

＜生産拠点を分散：収益性低＞



＜生産拠点を集中：収益性高＞



ASEAN諸国とインドの競合・補完関係をどうみるか①

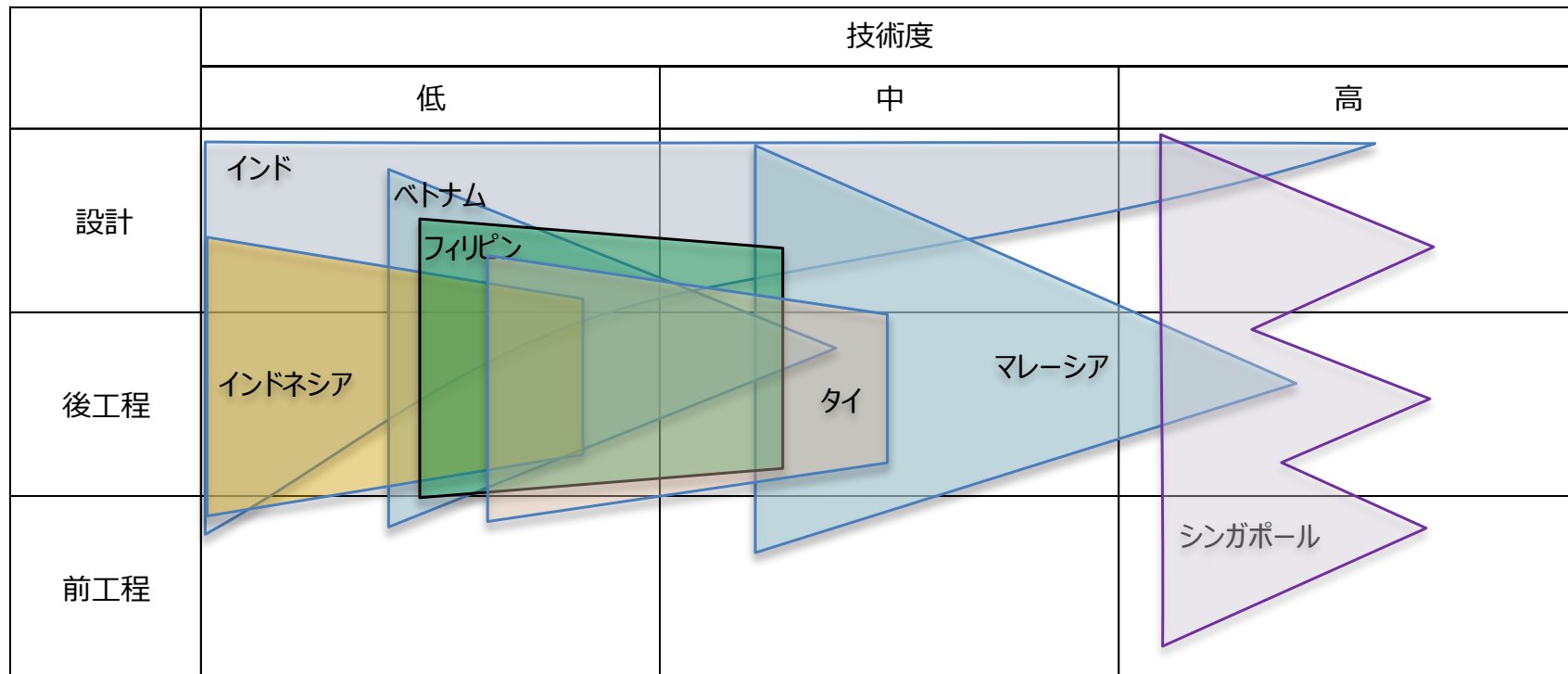
生産工程（設計、後工程、前工程）と技術度（低、中、高）の2軸で事業領域を分けて、各国の比較優位を考えることが重要

	技術度		
	低	中	高
設計	旧世代の半導体の設計カスタマイズ、設計設計した回路の動作検証、バグ（不具合）の特定	現在主流の半導体を特定用途向けにカスタマイズするための設計	回路線幅が非常に狭い先端半導体の論理設計や回路図の作成
後工程	旧世代の技術を用いた、回路線幅の広い半導体チップとリードフレームの接続、封止材を用いた加工	現在主流の技術を用いた、比較的回路線幅が狭い半導体チップの切り出しやリードフレームの接続	最先端の技術を用いた、回路幅が非常に狭い半導体チップの切り出し、複数の半導体チップの高密度な統合
前工程	旧世代の技術を用いた、回路線幅が広い回路パターンの形成	現在主流の技術を用いた、比較的回路線幅が狭い回路パターンの形成	最先端の技術を用いた、回路線幅が非常に狭い回路パターンの形成

（資料）日本総合研究所作成

ASEAN諸国とインドの競合・補完関係をどうみるか②

技術度の低いレガシー半導体の製造でインドネシア、フィリピン、ベトナム、インドは競合



(資料) 日本総合研究所作成

(注) 各国の電力、水、人材、労働コスト、エレクトロニクス産業の集積、労働コストなどを踏まえて、相対的に強みのあると考えられる領域を図示。

補完関係も深まっていく見込み

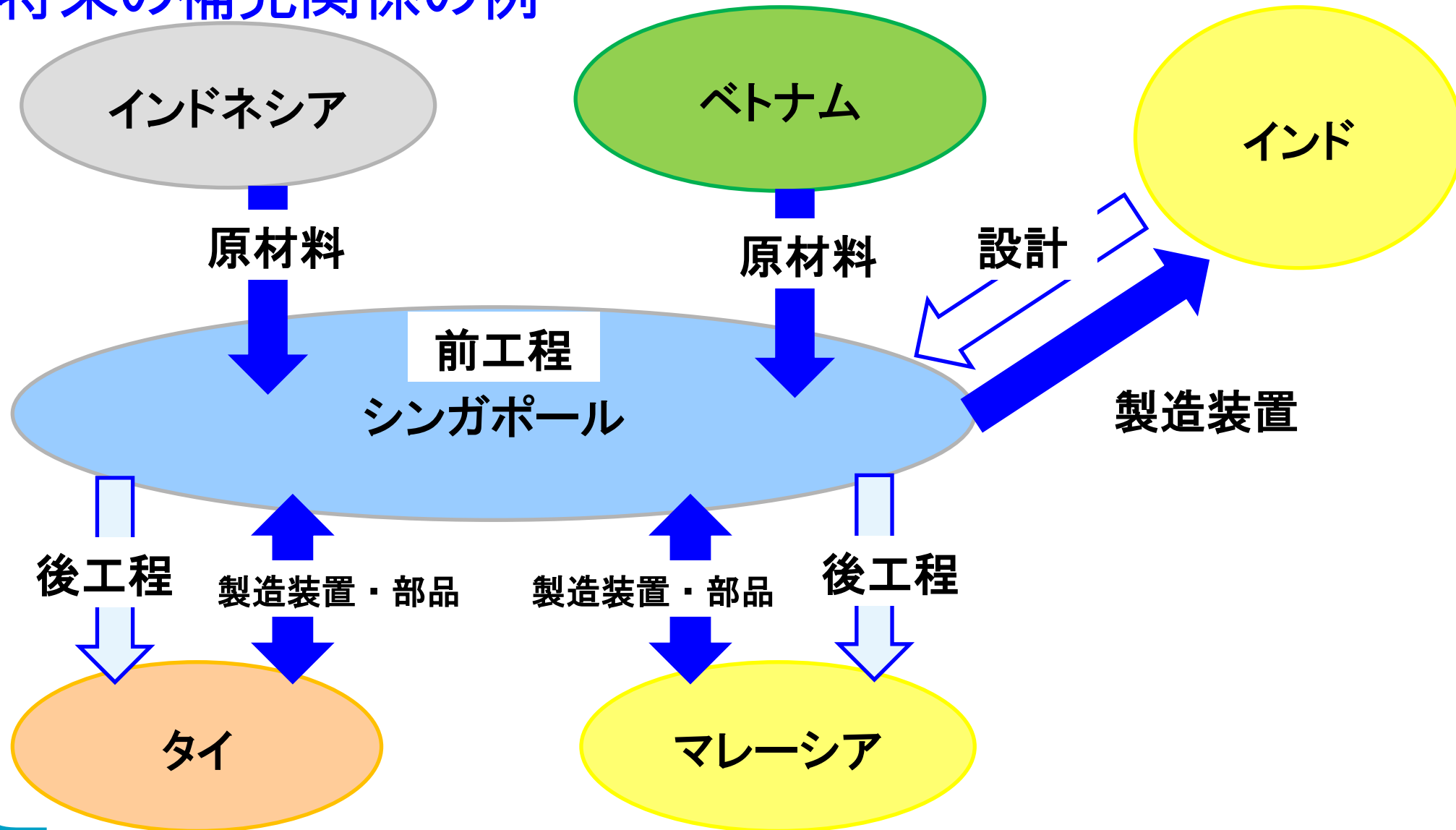
- 各国の比較優位は異なり、全て内製化することは困難

半導体の前工程と後工程に用いられる素材とその原材料

	素材とその概要		左記の原材料例
前工程	ウェハー	集積回路を形成する円盤状の基板	シリコン、ガリウム、ゲルマニウム
	フォトレジスト	光を用いてウェハー上に回路パターンを形成する際に使用される感光性薬品	ポリマー
	ウェハー洗浄液	ウェハーの洗浄に用いられる薬液	過酸化水素水、硫酸、フッ酸
	ドライエッチング用の高純度ガス	ウェハーの加工に用いられるガス	フッ素系ガス、塩素系ガス、
	成膜材料	ウェハー上に薄い膜を形成する際に用いられる材料	二酸化ケイ素
	研磨材（スラリー）	ウェハーの表面を平坦化する際に用いられる	ダイヤモンド、シリカ、アルミナ
後工程	リードフレーム	ウェハーから切り出されたチップを組み込むための土台として用いられる金属	銅、鉄
	ボンディングワイヤ	チップとリードフレームを接続するために用いられるワイヤー	金、銀、銅
	ダイボンド材	チップをリードフレームなどに接着するための材料	エポキシ樹脂、シリコン樹脂、
	封止材	チップを外部の湿気や衝撃から保護するための材料	エポキシ樹脂、シリコン樹脂、シリカ

（資料）各種報道、半導体関連企業のウェブサイトなどを基に日本総合研究所作成

将来の補完関係の例



ASEAN域内とASEAN・インド間のパートナーシップも徐々に拡大

ASEAN諸国とインドの半導体産業の連携に向けた最近の動向

連携強化に向けた取り組みの実施国・地域		協力の内容
ASEAN域内	ASEAN各国	2025年5月、SSIA（シンガポール半導体業界協会）がASEAN内のCOSTI（ASEAN科学技術イノベーション委員会）に対して「ASIA（ASEAN Semiconductor Industry Alliance、ASEAN半導体産業連盟）」の設立を提言
	マレーシア、シンガポール、フィリピン、タイ、ベトナム	2025年7月、マレーシアで開催されたASEAN諸国の半導体産業の国際会議「ASEAN半導体会議2025」で、各国の半導体産業の業界団体が域内のエコシステムの構築に向けた協力の覚書を締結 * SSIA（シンガポール半導体業界協会）、MSIA（マレーシア半導体産業協会）、SEIPI（フィリピン半導体・電子部品産業連盟）、THSIA（タイ半導体産業貿易協会）、VEIA（ベトナム電子協会）が覚書を締結
	シンガポールとマレーシア	2025年1月、半導体産業の二国間関係の強化を見据えた、「JS-SEZ（ジョホール・シンガポール経済特別区）」の設立について最終合意
	シンガポールとインドネシア	2025年6月、SSIA（シンガポール半導体業界協会）とKADIN（インドネシア商工会議所）、二国間の半導体産業の発展に向けた、共同イベントや情報交換などを含む協力の覚書を締結
	シンガポールとベトナム	2025年8月、シンガポールの半導体産業の業界団体SSIA加盟企業がベトナムを訪れ、ベトナムの半導体関連の産官学関係者と面談を実施。SSIA加盟企業とベトナム企業の連携を促進することで合意
ASEANとインド	シンガポールとインド	2024年9月、シンガポールからインドへの半導体産業の投資促進、R&Dや人材育成の二国間連携などを含む「インド・シンガポール半導体エコシステムパートナーシップ」を締結
	マレーシアとインド	2025年10月末にマレーシアで開催されるASEAN首脳会議にてマレーシアとインドの半導体パートナーシップを発表することを検討中（報道ベース）
	フィリピンとインド	2025年9月、フィリピンのマルコス大統領のインド訪問の際に、両国が半導体産業を含む戦略的パートナーシップの立ち上げを発表

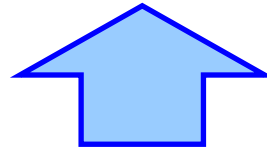
（資料）各種報道を基に日本総合研究所作成

以上を踏まえて：日本への含意

- 米国の求心力が低下する今こそ、日本が効率的なサプライチェーンの構築に向けてリーダーシップを発揮すべき

<案>

- ASEAN諸国とも半導体に特化したパートナーシップやイニシアティブを組成
- ASEAN・インド・韓国・台湾を含めた国際協力のイニシアティブ
- 米印関係の改善に向けた双方への働きかけ



こういった取り組みを実施するための出発点は
ASEAN・インドの半導体産業の現状・先行き・競合・
補完関係の正しい理解

ご参考(関連レポート)

- 熊谷章太郎[2024]「インドの半導体国産化計画の成否を分ける要因は何か」日本総合研究所『環太平洋ビジネス情報 RIM』2024 Vol. 24 No. 92
<https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/rim/pdf/14791.pdf>
- 熊谷章太郎[2026]「ASEAN・インドの半導体産業の現状と競合・補完関係」日本総合研究所『環太平洋ビジネス情報 RIM』2026 Vol. 26 No. 98
<https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/rim/pdf/16420.pdf>